**SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**FLEXIBLE THERMOPLASTIC STARCH FILMS FUNCTIONALIZED WITH COPPER PARTICLES FOR PACKAGING OF FOOD PRODUCTS**

**Olivia V. López1\*, María E. Villanueva2,3,4\*, Guillermo J. Copello2,3,**

**Marcelo A, Villar1,5**

1 Planta Piloto de Ingeniería Química, PLAPIQUI (UNS-CONICET), Camino La Carrindanga Km. 7, (8000) Bahía Blanca, Argentina

2 Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Química Analítica y Fisicoquímica, Junín 956, C1113AAD, Buenos Aires, Argentina;

3 CONICET − Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Quı́mica y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA), Buenos Aires, Argentina;

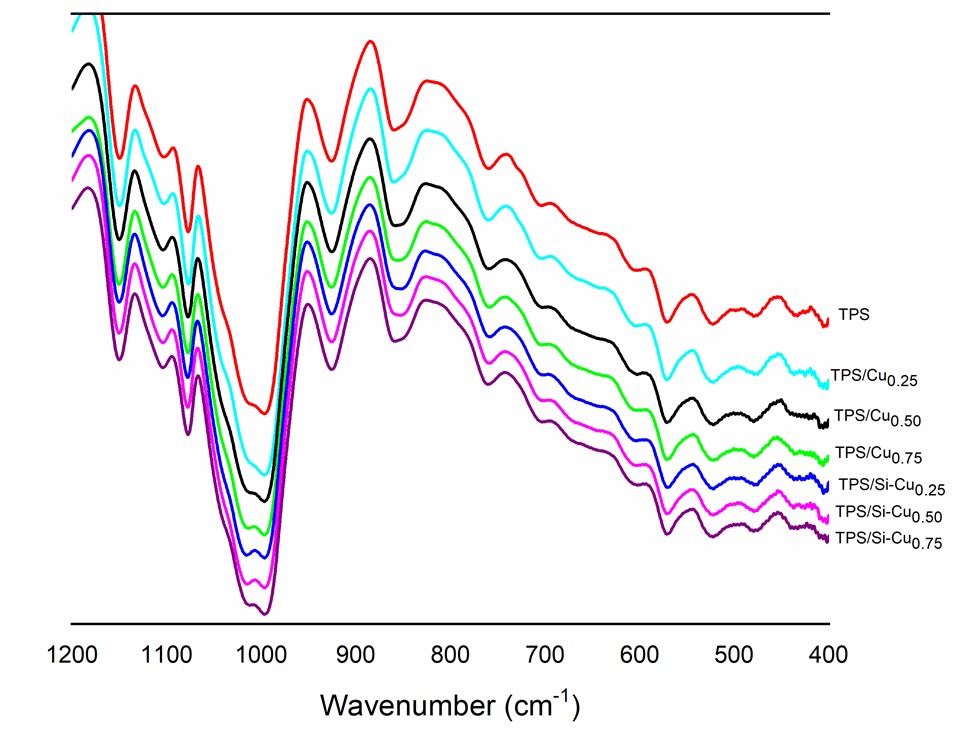
4 Universidad Nacional de Luján (UNLu), Departamento de Ciencias Básicas, Ruta 5 y 7, Luján, Buenos Aires, Argentina;

5 Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, (8000) Bahía Blanca, Argentina

**\*Corresponding authors:**

**Olivia V. López (**[**olivialopez@plapiqui.edu.ar**](mailto:olivialopez@plapiqui.edu.ar)**)**

**María E. Villanueva (**[**mevillanueva@ffyb.uba.ar**](mailto:mevillanueva@ffyb.uba.ar)**)**

****

**Figure S1.** FT-IR spectra of TPS films containing Cu and   
Si-Cu particles at different concentrations.



**Figure S2.** Stress-strain curves of TPS films containing a) Cu and   
b) Si-Cu particles at 0,75, 1, and 5 %.